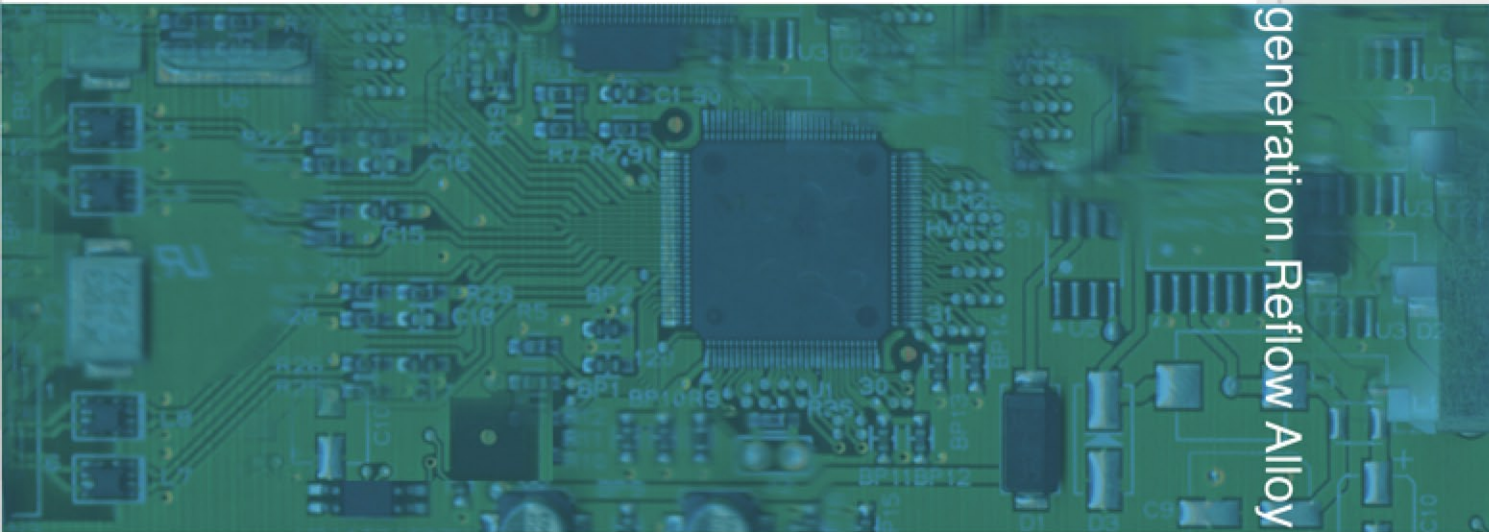


# PF1072-152TO

第2世代リフローJEITA推奨合金  
Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi

- 安定した連続印刷性  
Stable continuous printing performance.
- 優れた微小溶融性  
Excellent minute melting.
- 低銀系でありながら優れたボイド抑制効果  
Excellent void prevention effect even low silver content.



## ● 一般特性 General characteristics

項目 Items	代表特性 Typical Property	試験方法 Test method
合金組成 Alloy composition	Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi	-
粒度 Particles Size	20~38 μm	-
フラックス含有量 Flux content	11.5%	JIS Z 3197
ハロゲン含有量 Halide content (chlorine conversion)	0.02%	配合値 Blend Value
フラックスタイプ Flux type	ROLO	IPC J-STD-004
銅板腐食試験 Copper plate corrosion test	Pass	JIS Z 3284
クロム酸銀試験 Silver chromate paper test	Pass	JIS Z 3197
銅鏡試験 Copper mirror test	Pass	JIS Z 3197
絶縁抵抗試験 Electric insulation resistance test, SIR	40°C90%RH	6.4×10 <sup>12</sup> Ω
	85°C85%RH	7.7×10 <sup>9</sup> Ω
100gf以上粘着保持時間 Tackiness time of keeping 100gf (50kN/m <sup>2</sup> ) minimum	>96hours	JIS Z 3284
流動特性 Fluidity	粘度 Viscosity	200 Pa·s
	Ti値 Thixotropic index	0.60

上記特性値は代表値で保証値ではありません。The physical property values of above are not the specification of the product.

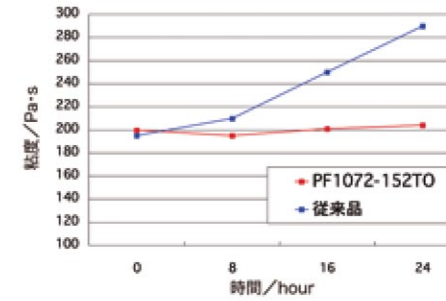
JEITA Recommended Second-generation Reflow Alloy

PF1072-152TO

# PF1072-152TO

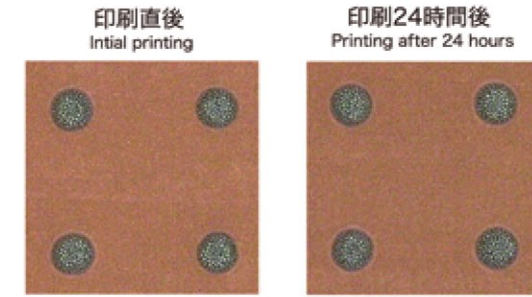
SMT用鉛フリーソルダペースト  
第2世代リフローJEITA推奨合金  
Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi

安定した連続印刷性  
Stable continuous printing performance.



24時間後でも粘度変化が小さい  
No change of viscosity after 24 hours

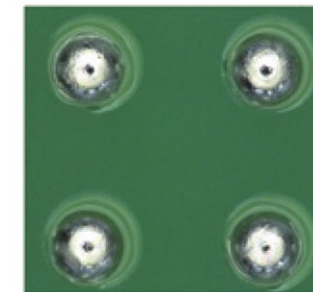
スキージ速度 Squeegee speed: 40mm/sec  
1時間あたりのストローク数 Strokes per hour: 400strokes/1hr



24時間後でも印刷形状の変化なし  
No change of printing form after 24 hours

メタルマスク厚み Metal mask thickness: 0.12t  
開口径 Opening size: 200μmφ

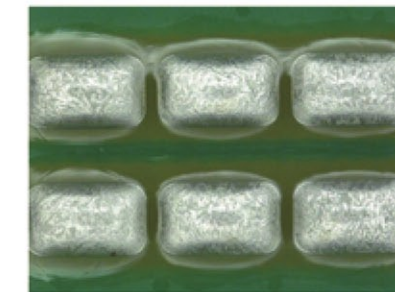
優れた微小溶融性  
Excellent minute melting.



良好な溶融性(200μmφ)  
Good melting

試験基板 Test board: CEM3  
メタルマスク厚み Metal mask thickness: 0.12t  
予備加熱 Preheating: 150-190°C 100sec  
ピーク温度 Peak temperature: 240°C

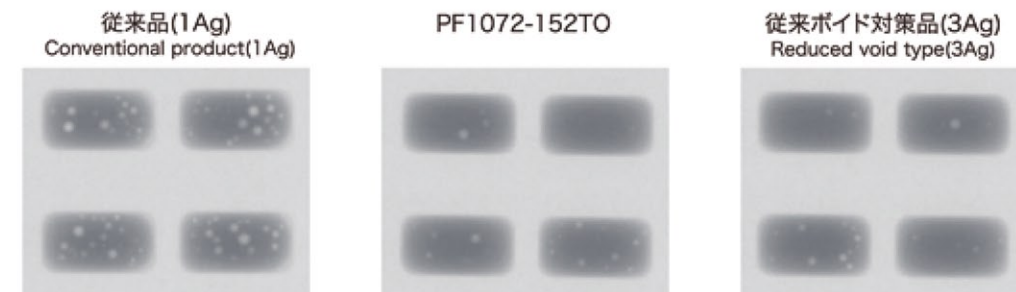
30°C7日後でも特性変化なし  
No characteristic change in 7 days of 30°C.



良好な濡れ性/はんだボール発生なし  
Good wettability /No solder ball

試験基板 Test board: CEM3  
予備加熱 Preheating: 150-190°C 100sec  
ピーク温度 Peak temperature: 240°C

低銀系でありながら優れたボイド抑制効果  
Excellent void prevention effect even low silver content.



ボイド率 void rate: 8.7%

ボイド率 void rate: 2.3%

ボイド率 void rate: 2.1%

試験基板 Test board: CEM3  
予備加熱 Preheating: 150-190°C 100sec ピーク温度 Peak temperature: 240°C

JEITA Recommended Second-generation Reflow Alloy PF1072-152TO